

杭州晶华微电子股份有限公司

2026 年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告

杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）为积极响应落实关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行“以投资者为本”的发展理念，维护公司全体股东利益，结合自身发展战略和经营情况，于 2026 年 4 月 29 日发布了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，共同促进科创板市场平稳运行。2026 年上半年，公司根据行动方案内容，积极推动并落实相关举措，现将上半年的具体情况公告如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质效

2026 年上半年，全球半导体市场景气度回升，但下游需求结构分化显著，晶圆代工及封装测试产能持续紧张、价格不断上涨，产业链各环节正迎来机遇与挑战并存的复杂态势。报告期内，公司前期推出的新产品持续推广、客户导入及规模出货，加之市场行情好转、终端需求改善，公司实现营业收入 10,716.65 万元，同比增长 36.31%；实现归属于母公司所有者的净利润-201.94 万元，同比减亏 91.21%。其中，第一季度，公司实现营业收入 4,609.90 万元，同比增长 24.46%；归母净利润亏损 441.05 万元，同比减亏 56.50%；第二季度，公司实现营业收入 6,106.75 万元，同比增长 46.86%；归母净利润 239.11 万元，同比增长 118.65%。公司营收保持稳健增长，盈利持续改善。

（一）业务发展动态

2026 年上半年，公司医疗健康 SoC 芯片产品销量同比增长 29.12%，收入同比增长 56.58%，占公司主营业务收入比例 39.62%；工业控制及仪表芯片产品销量同比增长 38.56%，收入同比增长 24.41%，占公司主营业务收入比例 37.97%；智能感知芯片产品销量同比增长 47.48%，收入同比增长 19.20%，占公司主营业务收入比例 20.69%；电池管理芯片产品销量同比增长 1,004.80%（主要系上年同期基数较低），收入同比增长 732.90%（同上），占公司主营业务收入比例 1.72%。公司主营业务毛利率为 49.68%，同比减少 1.21 个百分点，主要系晶圆代工及封装价格上涨，成本相应增加所致。其中，晶华微主营业务毛利率 54.57%，同比减少 2.69 个百分点，晶华智芯主营业务毛利率 29.67%，同比减少 3.99 个百分点。

综合来看，本报告期公司营收实现同比增长，主要为以下三方面驱动：一是医疗健康 SoC 芯片业务中，血糖仪芯片、血压计芯片已向国内头部品牌客户完成批量交付并持续放量，销量同比增长 172.01%，收入同比增长 215.33%；二是得益于宏观贸易环境改善与终端需求恢复，仪器仪表芯片销量同比增长 38.14%，收入同比增长 30.31%，智能家电芯片销量同比增长 20.97%，收入同比增长 19.14%；三是新一代信号调理及变送输出芯片与电池管理芯片等市场拓展顺利，销量稳步提升。

（二）产品研发进展

公司持续重视研发投入，本报告期研发费用 4,091.62 万元，同比减少 11.43%，占营业收入比重为 38.18%。截至报告期末，公司研发人员 141 名，占员工总数 61.30%。报告期内，公司在各产品领域研发取得积极进展：

医疗健康领域，高性价比智慧健康测量 SoC 系列芯片已全部完成测试，进入量产阶段；动态血糖仪 AFE 芯片、4/8 电极 BIA AFE 芯片等多个项目正加紧样片测试与验证；新一代 HCT 血糖仪 SoC 芯片已于上半年立项，计划于三季度完成流片。

工控仪表领域，中高端万用表 SoC 芯片已完成首版样片测试，正进行迭代优化；面向高性价比的新一代自动量程万用表 SoC 芯片已立项，设计工作正积极推进；传感器及变送器全自动标定与温补系统项目、LCR 数字电桥方案开发及带电感测量功能的万用表方案均已完成研发，逐步落地于客户应用。

智能感知领域，高性价比 8 位 MCU 芯片已顺利量产；相关触控方案、开发工具及 FOC 算法等均已完成技术储备，具备客户交付能力；面向更高性能需求，下一代 32 位 MCU 及配套开发工具的研发已全面展开。

电池管理领域，多款保护芯片及高性能系统板卡方案已进入量产；系列 AFE 芯片与高串数电池监控保护芯片正持续优化并扩大客户试用；面向主动均衡应用的新一代 AFE 芯片已于上半年完成立项，前期设计正积极推进。

物联网领域，双模蓝牙 SoC 芯片已顺利流片，样片验证有序开展；BLE 蓝牙 SoC 芯片设计加速推进，计划于第三季度送出流片。

（三）产能保障举措

报告期内，面对晶圆代工及封装测试产能紧张与价格上涨的行业形势，公司

积极采取多项举措保障产能供应与交付稳定。一方面，持续加强与核心供应商的深度合作，建立长期稳定伙伴关系，提升交付可靠性与供应韧性；另一方面，推动与晶华智芯的资源共享，提升运营协同效率与供应资源竞争力。同时，公司持续优化库存结构，灵活管理库存水平，完善风险应对机制。公司将持续提升产能保障能力，筑牢业务稳健发展的供应基础。

（四）日常经营管理

报告期内，公司严格遵循《公司法》《证券法》等法规要求，全面开展内控体系优化工作，系统梳理并动态更新制度体系，持续强化风控、审计及关键业务流程管控。目前，公司已建立科学高效的治理机制，有效保障各项经营活动合法合规、有序开展。

公司持续重视价值传播与品牌宣传，深化公众号、视频号等自有平台运营，持续输出技术科普内容；同时积极参加行业展会及技术交流会，并自主筹办新品暨全场景解决方案推介会，多维度展示技术实力与产品优势，持续扩大品牌影响力。报告期内，公司荣获 2026 年中国 IC 领袖峰会“模拟芯片公司 TOP 10”称号和“年度电源管理 IC 产品奖”；在 2026 杭州国际半导体与集成电路产业创新展览会（杭州长芯展）上，公司荣获“IC 设计卓越奖”。

二、加强募投项目管理，提升科技创新能力

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 52,392.84 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），公司募集资金实际使用及结余情况如下：

金额单位：人民币万元

发行名称	2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022 年 7 月 26 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项 目	金 额
一、募集资金总额	104,798.72
其中：超募资金金额	17,053.70
减：直接支付发行费用	12,745.02
二、募集资金净额	92,053.70

减：	
以前年度已使用金额	40,128.29
本年度使用金额	4,396.13
现金管理金额	45,600.00[注 1]
加：	
募集资金利息收入	4,863.55[注 2]
三、报告期期末募集资金余额	6,792.84[注 3]

[注 1]截至 2026 年 6 月 30 日，理财产品余额 45,600.00 万元尚未到期

[注 2]利息收入净额包含购买理财产品产生的投资收益金额

[注 3]1.包含以协定存款方式存放于募集资金专户的余额，未包含已用于现金管理的募集资金（即[注 1]）

2.明细项目金额加计之和与合计数有尾差，系四舍五入所致

由于截至 2026 年 6 月 30 日止，公司尚未实施 2026 年第二季度募集资金等额置换事项，故上述募投项目明细表未体现公司 2026 年第二季度募集资金使用的情况。至本报告披露日，公司已实施完成 2026 年第二季度募集资金等额置换事项，具体如下：

募投项目	置换金额（元）
智慧健康医疗 ASSP 芯片升级及产业化项目	6,186,772.44
工控仪表芯片升级及产业化项目	2,725,017.64
研发中心建设项目	4,576,592.34
合计	13,488,382.42

自首发募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的实施工作，审慎规划募集资金的使用。但由于经历了半导体市场周期性调整及需求结构性下滑，全球消费电子市场需求疲软，半导体行业持续了较长的去库存阶段，且因行业技术快速迭代，客户需求与市场竞争状况也不断演变，为应对市场环境的变化，提高募投项目的整体质量和募集资金的使用效果，公司紧密结合市场的最新动态以及客户的切实需求，基于合理有效使用募集资金的原则，在募投项目的推进上更加谨慎、严谨、科学，整体进度较原计划适当放缓，以有效控制成本、降低风险、提高资产流动性。公司于 2025 年 7 月 10 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届

监事会第十一次会议，于 2025 年 7 月 29 日召开了公司 2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于募投项目延期、终止以及增加实施内容、实施主体、实施地点的议案》，“智慧健康医疗 ASSP 芯片升级及产业化项目”“工控仪表芯片升级及产业化项目”“研发中心建设项目”实施期限延长至 2027 年 7 月，“高精度 PGA/ADC 等模拟信号链芯片升级及产业化项目”终止实施，“研发中心建设项目”增加实施主体全资子公司深圳晶华智芯微电子有限公司，增加实施内容智能家电控制芯片的开发设计研究。

公司将持续加强募投项目管理，审慎使用募集资金，进一步提高募集资金使用效率，以募投项目的落地促进公司主营业务发展，增强公司整体盈利能力。

三、优化财务管理，增强组织效能

公司高度重视财务管理，持续加强与各业务部门和会计师事务所的紧密联系，增强业务管控与监督力度，切实提高会计核算的及时性和准确性，确保财务报告信息质量；同时，持续深化预算管理落地实施，健全资金全流程闭环管控体系，优化科学规范、运转高效的财务运行机制。报告期内，公司统筹上下游供需协同，搭建稳定高效的供应链体系，提升供应链整体周转效率；建立动态库存预警与产销联动机制，细化安全库存标准，常态化推进呆滞、积压存货梳理处置，优化存货结构，加速存货流通；公司持续完善客户信用分级管控体系，通过账期动态调整、逾期账款专项催收等手段加速资金回笼，严控坏账风险；公司继续强化资金支付分级授权与使用全链条监督，优化闲置资金统筹运作，保障经营性现金流稳健充裕。

通过上述多维度精细化运营管控，公司经营效率持续改善，财务风险防控底盘进一步夯实，为公司经营目标落地及可持续发展提供坚实支撑。

四、规范内控管理，提升运营效率

报告期内，公司高度重视企业规范治理及合规运营效率，持续梳理公司内部控制及执行情况，不断优化和健全内控体系与制度流程。根据相关法律法规和监管规定，公司于 2026 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订和制定部分治理制度的议案》，完成了《内部审计制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《市值管理制度》的修订或新增工作，进一步从制度建设层面夯实业务风险管控基础，提升规

范运作水平和风险防范能力。

此外，公司积极深化独立董事履职机制，充分发挥独立董事在公司治理中的监督作用，听取独立董事对于公司加强内部控制风险防范机制的重要性的建议，及时向独立董事报告公司的相关重大事项，保障独立董事的知情权、监督权，努力提升公司治理的合规性、有效性和开放性。公司设有内部审计机构，向公司审计委员会进行汇报，通过每季度内部审计工作总结，向审计委员会及公司管理层汇报内部审计工作，发现公司在内部控制环节中的各项风险，跟踪核验整改成效，确保风险可控。公司亦积极组织董事、高级管理人员及相关人员参与证监会、交易所和各级上市公司协会等举办的培训，不断提升其专业素养和合规意识，以推动公司董事和高级管理人员尽职履责。报告期内，公司已组织董事和高级管理人员参加了上市公司财务规范运作重点关注事项专题培训、沪市公司规范运作主题培训和浙江辖区上市公司治理专题培训等，深入学习证券市场相关法律法规，确保公司运作的规范性和合规性。

公司将持续完善治理制度，充分发挥独立董事在参与决策、专业咨询、制衡监督等方面的作用，并通过常态化参与监管培训，确保董事及高级管理人员勤勉履职，推动公司治理水平的有效提升。

五、重视股东回报，兼顾长远发展

公司始终坚持投资者利益至上原则，并已建立了长期、稳定、持续的股东分红回报机制，充分保障全体股东的合法权益。2022 年度，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），合计派发 998.40 万元，占当年净利润比例为 45.13%；2023 年度，公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股；2024 年度，公司继续以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。此外，基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，公司开展了以集中竞价交易方式回购公司股份的计划：2023 年 8 月 19 日，公司发布了回购公司股份的方案；2024 年 7 月 30 日，公司完成回购，通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 576,760 股，累计支付的资金总额为人民币 2,198.47 万元（含印花税、交易佣金等交易费用）。公司根据各年度实际经营情况，灵活采用现金分红、股份回购及资本公积转增股本等多种方式，持续维护全体股东的合法权益。

2026 年上半年，公司在股东回报方面秉持审慎务实原则。经公司 2025 年度

股东会审议通过，2025 年度利润分配方案为不进行现金分红、不送股、不以资本公积转增股本。该方案主要基于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负、未实现盈利的实际情况，同时考虑公司目前经营发展的资金需求及全体股东的长远利益。

2026 年上半年，公司持续深化医疗健康、工控仪表、智能感知、电池管理及物联网等领域布局，前期研发投入正加速转化为量产产品，市场拓展成效亦正逐步显现，实现营收稳健增长并改善盈利水平，归属于上市公司股东的净利润实现同比较大减亏。公司将在保证正常经营的前提下，结合业务现状、未来发展规划以及行业发展趋势，从有利于公司可持续发展和投资者长期回报的角度出发，与广大投资者共享公司发展成果。

六、提高信披质量，加强投关交流

报告期内，公司严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司定期报告、临时公告等重大信息。同时，公司以投资者需求为导向，持续提升信息披露内容的可读性和有效性，切实维护投资者权益。

公司亦注重投资者关系管理工作，为进一步深化与资本市场的双向互动，公司也借助新媒体平台工具，在合规范围内传递公司经营情况和技术创新等信息，扩大了信息传播的覆盖面，确保了信息披露的广泛性和平等性。报告期内，公司通过“上证路演中心”等平台举行了 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会，实时解答了投资者关注的主要问题，实现了即时的双向沟通。除此之外，公司组织、参加了多场次的投资者沟通交流活动，并通过投资者热线、投资者调研、上证 e 互动、电子邮箱等多种形式，将公司价值有效传递给资本市场，让投资者对公司有更好理解和认可的同时，也将投资者的关注点、观点等及时反馈给公司管理层，增进交流互信，维护投资者权益。

七、强化利益共担共享，压实“关键少数”责任

公司持续完善长效激励体系，通过股权激励等多元化方式有效激发管理团队与核心人才的积极性，公司自上市以来推出了 2023 年限制性股票激励计划和 2024 年限制性股票激励计划。报告期内，因 2023 年限制性股票激励计划部分激

励对象离职、首次授予第二个归属期和第三个归属期公司层面业绩考核均未达到触发值目标，经公司第二届董事会第二十三次会议审议，公司作废了相应限制性股票。股票激励计划能进一步激发公司管理层及员工等的责任感、使命感，强化目标责任意识，使其利益与公司长远发展有机结合，提升公司发展质量，增强投资者回报，切实强化管理层及核心骨干与股东利益的共担共享。

报告期内，公司根据《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求，建立了董事和高级管理人员薪酬管理制度，完善激励约束机制，提升公司薪酬管理规范性水平，保护公司股东的利益。同时，公司始终重视“关键少数”在公司生产经营过程中的重要作用，持续加强与“关键少数”的沟通交流，积极组织相关方参加监管机构举办的各种培训，并通过合规提醒等方式不断强化合规意识和履职责任，赋能“关键少数”引领企业持续稳定发展。

八、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，努力提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，履行上市公司责任和义务，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

杭州晶华微电子股份有限公司

董事会

2026年8月8日